



## ENGLISH

“The announcement of imec's German headquarters in Baden-Württemberg at our IPAI SPACES in Heilbronn marks a significant milestone for our innovation platform. This expansion does not only significantly strengthen our existing ecosystem but also fortifies Europe's position across the entire AI value chain. At IPAI, imec will find all the necessary prerequisites, merging its expertise with data and industry insights from small and medium-sized enterprises, hidden champions, and global leaders in their fields. This partnership will enhance our community and improve opportunities and outcomes for future generations of innovative excellence.”

– Moritz Gräter, CEO IPAI

## DEUTSCH

„Die Ansiedlung des deutschen Hauptsitzes von imec in Baden-Württemberg, innerhalb unserer IPAI SPACES, wird unsere KI-Innovationsplattform erheblich stärken. Diese Partnerschaft wird nicht nur Europas Expertise entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette entscheidend voranbringen, sondern auch für die Zukunft stark aufstellen. Imec wird im Heilbronner Ökosystem und bei IPAI die besten Voraussetzungen vorfinden, um sich mit führenden Institutionen, KMUs, ‚Hidden Champions‘ und Weltmarktführer auszutauschen und damit neue Chancen und Möglichkeiten für zukünftige Innovationen ‚made in Europe‘ zu schaffen.“

– Moritz Gräter, CEO IPAI

---

## PRESS CONTACT

Jan Denia | Press Officer

+49 1525 9576382 | [press@ip.ai](mailto:press@ip.ai)

**PROF. REINHOLD R. GEILSDÖRFER,  
VORSITZENDER GESCHÄFTSFÜHRER DER DIETER SCHWARZ STIFTUNG**

Wir freuen uns sehr, dass mit imec ein international führendes Chip-Forschungsinstitut nach Heilbronn kommen wird. Dies ist für die Weiterentwicklung unseres vielfältigen Ökosystems von großer Bedeutung und ein Gewinn für die im Aufbau befindliche Forschungslandschaft.

**PROF. REINHOLD R. GEILSDÖRFER, CEO DIETER SCHWARZ FOUNDATION**

We are delighted that imec, a leading international chip research institute, will be coming to Heilbronn. This is of great importance for the further development of our diverse ecosystem and an asset for the research landscape that is currently being established.

**Pressekontakt**

Julia Bohrmann  
Kommunikation

[presse@dieter-schwarz-stiftung.de](mailto:presse@dieter-schwarz-stiftung.de)



**Michael Budde, Vorsitzender des Bereichsvorstands Bosch Mobility Electronics**

„Mikroelektronik ist in vielen Branchen nicht mehr wegzudenken. Gerade in Baden-Württemberg mit seinem starken Automobil-Sektor ist sie ein wichtiger Innovationstreiber. Die Ansiedlung von imec ist eine sehr gute Nachricht für den nationalen Halbleiterverbund und die europäische Halbleiterindustrie insgesamt. Sie koppelt das regionale Automotive-Ökosystem mit einem weltweit führenden, unabhängigen Forschungsinstitut, das sich bei Halbleiter-Design und -Integration durch hohe Kompetenz auszeichnet. Zudem stärkt die Ansiedlung von imec die Halbleiter-Kompetenz in Baden-Württemberg und baut Brücken zwischen Forschung und Industrialisierung. Bereits seit 2022 arbeiten imec und Bosch erfolgreich bei wichtigen strategischen Innovationsthemen zusammen.“

**Michael Budde, President Bosch Mobility Electronics**

“Microelectronics has become indispensable in many industries. In Baden-Württemberg in particular, with its strong automotive sector, it is an important driver of innovation. The establishment of imec is very good news for the national semiconductor network and the European semiconductor industry as a whole. It links the regional automotive ecosystem with a world-leading, independent research institute with a high level of expertise in semiconductor design and integration. In addition, the establishment of imec strengthens semiconductor expertise in Baden-Württemberg and builds bridges between research and industrialization. imec and Bosch have been working together successfully on important strategic innovation topics since 2022.”

**Pressekontakt:**

Athanassios Kaliudis

External Communications - Technology and innovation (C/CGC-EC2)

Tel.: +49 711 811-7497

Athanassios.Kaliudis@de.bosch.com

**Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka, Präsident der Fraunhofer Gesellschaft**

„Die Chiplet-Technologie ist eine wesentliche Schlüsselkomponente für die nächste Generation von Halbleitern. Wir erwarten, dass diese neue Technologie Innovationen in sämtlichen Industrien befeuern wird, sei es die Automobilwirtschaft, die Luft- und Raumfahrt oder die Künstliche Intelligenz.

In dem jüngst gestarteten APECS-Projekt legt die Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland zusammen mit ihren europäischen Partnern den technologischen Grundstock für eine Pilotfertigung im Bereich Chiplets. Die Gründung des ›Nationalen Chiplet Centers‹ ist für uns der nächste logische Schritt. Wir werden dort mit der Industrie Use-Cases unter Berücksichtigung der jeweiligen branchenspezifischen Randbedingungen analysieren, technologische Lösungen ableiten und die in APECS entstehende Pilotlinie an den Bedarfen der Industrie ausrichten.

Dies ist ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zu einer internationalen Führungsrolle bei der Entwicklung und Produktion von Chiplets und damit ein wichtiger Beitrag zur technologischen Souveränität und wirtschaftlichen Stärke Deutschlands und Europas. Durch die Fraunhofer-typische enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie in Europa können wir die Innovationskraft der Chiplet-Technologie optimal nutzen, um neue Entwicklungen schnell in die Anwendung zu überführen und damit einen echten Wettbewerbsvorteil auf internationaler Ebene erreichen.“

**Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka, President of the Fraunhofer-Gesellschaft**

“Chiplet technology is a key component for the next generation of semiconductors. We expect this new technology to fuel innovation across industries, be it automotive, aerospace or artificial intelligence.

In the recently launched APECS project, Research Fab Microelectronics Germany (FMD) has teamed up with European partners to develop the technological foundations for pilot production of chiplets. We believe that establishing a national chiplet center is the next logical step. Based on industry-specific boundary conditions, this is where we will analyze use

cases together with companies, derive technological solutions and align the pilot line being established in the APECS projects with industry needs.

This will be a decisive milestone on the way to becoming an international leader in the development and production of chiplets and thus an important contribution to the technological sovereignty and economic strength of Germany and Europe. The close collaboration between research and industry across Europe, as exemplified by Fraunhofer, will enable us to optimally leverage the innovative strength of chiplet technology. This will allow us to quickly transfer new developments into applications, thereby achieving a real competitive advantage on an international level.”

**Pressekontakt:**

Thomas Eck

Abteilungsleiter Presse und strategische Kommunikation

Tel.: +49 89 1205-1316

[thomas.eck@zv.fraunhofer.de](mailto:thomas.eck@zv.fraunhofer.de)



Karlsruher Institut für Technologie

„Die Ansiedelung von imec bedeutet eine deutliche Stärkung des Standortes Deutschland in der Mikroelektronik. Insbesondere die Bereiche Mobilität, Medizintechnik sowie Robotik und Industrie 4.0 werden davon profitieren, um nur einige zu nennen.“, freut sich **Jan S. Hesthaven, Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)**.

„Baden-Württemberg ist aufgrund der zahlreichen Automobil- und Zulieferfirmen als kundenspezifischer Standort für imec ideal. Wir am KIT wissen durch unsere langjährige Kooperation, wie wertvoll imec als Partner ist. Die Ansiedlung wird Deutschlands, aber auch Europas strategische Autonomie im aktuellen geopolitischen Umfeld enorm stärken.“

“imec’s siting in Baden-Württemberg will significantly strengthen Germany and its microelectronics sector. It will particularly benefit the areas of mobility, medical engineering, robotics, and industry 4.0, to name a few,” says **Jan S. Hesthaven, President of Karlsruhe Institute of Technology (KIT)**.

“Baden-Württemberg with its numerous automotive companies and suppliers is an ideal customer-specific location for imec. Thanks to our long-standing collaboration, we at KIT know very well what valuable partner imec is. This siting will massively push both Germany’s and Europe’s strategic autonomy in the current geopolitical environment.“

**Pressekontakt:**

Christian Koenemann  
Pressesprecher

Tel.: +49 721 608-41105  
Christian.Koenemann@kit.edu

# PORSCHE

## **Dr. Michael Steiner, Mitglied des Vorstands für Forschung und Entwicklung der Porsche AG**

„Als Hersteller exklusiver Sportwagen ist die Entwicklung kundenorientierter Softwarefunktionen für uns von großer Bedeutung. Der Einsatz von Chipllets wird uns ermöglichen, markendifferenzierende Softwarelösungen zu schaffen. Die Ansiedlung von imec in Baden-Württemberg gibt uns die Möglichkeit, unsere Kooperation auszubauen. Wir werden gemeinsam noch intensiver an zukunftsweisenden und markendifferenzierenden Softwarelösungen arbeiten.“

## **Dr. Michael Steiner, Member of the Executive Board for Research and Development at Porsche AG**

“As a manufacturer of exclusive sports cars, the development of customer-oriented software functions is of great importance to us. The use of chiplets will enable us to create brand-differentiating software solutions, and imec setting up in Baden-Württemberg gives us the opportunity to expand our cooperation with them. This means that we will be able to work together ever more closely on future-oriented and brand-differentiating software solutions.”

### **Pressekontakt**

Benedikt Griffig  
Pressesprecher Forschung und Entwicklung, Car-IT

Tel.: +49 (0) 1520 911 5228  
benedikt.griffig1@porsche.de



**Christophe Périllat, Valeo's Chief Executive Officer**

„Um die Rechenanforderungen für das Software-definierte Fahrzeug zu erfüllen, verspricht eine offene und heterogene Chiptlet-Architektur ein neues Kosten- und Leistungsniveau. Aus diesem Grund ist Valeo Gründungsmitglied des Automotive Chiptlet Program. Chiptlet-Architekturen werden neue Fähigkeiten für Automobilentwickler erfordern, die im Herzen der Automobilgeschichte, in Baden-Württemberg, von imec nun ausgebaut werden. Valeo mit seinem Mobility Tech Center in der Nähe von Stuttgart ist von dieser Initiative begeistert und wird eng mit dem neuen Team zusammenarbeiten.“

**Christophe Périllat, Valeo's Chief Executive Officer**

"To meet the computing requirements for the Software-Defined Vehicle, an open and heterogeneous chiptlet architecture promises to deliver a new level of cost and performance. That's why Valeo is a founding member of the Automotive Chiptlet Program. Chiptlet architectures will require new skills for automotive developers, which imec will now grow in the heartland of automotive history, Baden-Württemberg. Valeo, with its Mobility Tech Center near Stuttgart is thrilled by this initiative and will closely collaborate with the new team."

**Pressekontakt:**

Andreas vom Bruch  
Director Communications Germany

Tel.: +491622320803  
andreas.vom-bruch@valeo.com



„Die strategische Partnerschaft zwischen Imec und ZEISS unterstreicht, wie eine enge Zusammenarbeit unter europäischen Partnern Innovationen beschleunigt und Europas Stellung im Halbleiter-Ökosystem stärkt“, erklärt **Dr. Thomas Stammler, Chief Technology Officer und Mitglied im Management von ZEISS SMT**. „Die Halbleiterindustrie besteht aus einem großen Netzwerk an Partnern und nur gemeinsam ist es möglich innovative Technologien von morgen weiter voranzutreiben.“

"The strategic partnership between Imec and ZEISS emphasizes how close collaboration among European partners accelerates innovations and strengthens Europe's position in the semiconductor ecosystem," explains **Dr. Thomas Stammler, Chief Technology Officer and member of the management of ZEISS SMT**. "The semiconductor industry consists of a large network of partners, and only together is it possible to further advance the innovative technologies of tomorrow."

**Pressekontakt:**

Jeannine Rapp  
Head of Communication and Implementation of Group Initiatives  
ZEISS Sparte Semiconductor Manufacturing Technology

Telefon: +49 7364 20 75435  
jeannine.rapp@zeiss.com